

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简况

股票简称	晶方科技	股票代码	603005
股票上市交易所	上海证券交易所	上海证券交易场所	
联系人及联系方式	董事会秘书	财务负责人	
姓名	汪洪田	胡勇	
电话	0512-67730001	0512-67730001	
传真	0512-67730008	0512-67730008	
电子邮箱	info@jwf.com.cn	info@jwf.com.cn	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年末末	本报告期末比上年末末增减(%)
总资产	1,760,969,126.84	1,061,318,853.90	65.92
归属于上市公司股东净资产	1,470,439,661.57	790,777,560.89	95.86
经营活动产生的现金流量净额	95,597,905.65	85,073,528.65	12.37
营业收入	271,575,637.21	198,532,298.09	36.79
归属于上市公司股东的净利润	86,303,878.94	72,433,580.11	19.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,339,685.91	71,622,609.43	10.80
归属于上市公司股东的净资产	6.45	10.45	减少24个百分点
基本每股收益(元)	0.39	0.38	2.63
稀释每股收益(元)	0.39	0.38	2.63

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

报告期末股东总数	16,308
----------	--------

前十大股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量
ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGIES LTD	H股境外法人	25.21	57,160,964	无
中芯国际集成电路制造(上海)有限公司	境内法人	24.28	55,048,276	55,048,276
OMNIVISION HOLDING (HONG KONG) COMPANY LIMITED	境外法人	13.35	30,261,687	30,261,687
苏州工业园区厚成企业管理有限公司	境内非国有法人	1.69	3,826,731	3,826,731
CHILAD GAL-08	境内自然人	1.36	3,530,530	3,530,530
苏州工业园区管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.43	3,236,688	3,236,688
苏州恒基资本一期有限合伙	未知	1.08	2,441,239	0
苏州恒基资本二期有限合伙	境内非国有法人	0.72	1,632,113	1,632,113
中国工商银行-中证500交易型开放式证券投资基金	未知	0.53	1,200,000	0
上海浦东发展银行-一般存款说明	公司和未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动关系			

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

一、控股股东变更

2014年上半年,全球半导体景气持续回暖,我国集成电路产业继续保持增长态势,在此背景下,公司积极推进项目建设,有效提升封装产能;不断加大对技术的持续研发投入,推进12寸WLCSP封装技术的量产工作;不断拓展市场应用领域,营造市场增长动力;与新产品合作模式,公司经营业绩保持了快速增长,报告期内,公司实现营业收入2,271,375,637.21元,同比增长36.79%;净利润186,303,878.94元,同比增长19.15%。

3.1 主要业务分析

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	271,575,637.21	198,532,298.09	36.79
营业成本	125,707,915.72	88,038,857.36	42.79
销售费用	595,685.64	722,283.41	-17.53
管理费用	55,001,194.89	24,252,352.39	126.79
财务费用	-4,599,447.73	1,686,880.70	-372.66
经营活动产生的现金流量净额	95,597,905.65	85,073,528.65	12.37
经营活动产生的现金流量净额	109,827,488.21	-150,951,629.59	-27.25
经营活动产生的现金流量净额	61,972,498.42	61,291,400.00	1,288.37
研发投入	41,749,842.68	12,213,371.76	241.84

营业收入变动原因说明:封装出货量增加所致
营业成本变动原因说明:销售规模增加所致
销售费用变动原因说明:员工费用、差旅费增加所致
管理费用变动原因说明:研发费用增加所致
财务费用变动原因说明:利息收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:支付公共行政费用增加所致
研发支出变动原因说明:技术开发与创新产生的研发投入增加所致

3.2 行业、产品及地区经营情况分析

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
电子元件	271,368,932.93	125,694,165.97	53.68	36.76	42.81	减少1.96个百分点

3.3 主要业务分地区情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
芯片封装	269,092,967.15	125,525,442.58	53.15	37.04	42.86	减少1.90个百分点
设仪器	209,925,967.78	168,723.39	92.59	10.34		减少30.05个百分点

五、其他披露事项

5.1 不适用

5.2 不适用

5.3 不适用

5.4 不适用

5.5 不适用

5.6 不适用

5.7 不适用

5.8 不适用

5.9 不适用

5.10 不适用

5.11 不适用

5.12 不适用

5.13 不适用

5.14 不适用

5.15 不适用

5.16 不适用

5.17 不适用

5.18 不适用

5.19 不适用

5.20 不适用

5.21 不适用

5.22 不适用

5.23 不适用

5.24 不适用

5.25 不适用

5.26 不适用

5.27 不适用

5.28 不适用

5.29 不适用

5.30 不适用

5.31 不适用

5.32 不适用

5.33 不适用

5.34 不适用

5.35 不适用

5.36 不适用

5.37 不适用

5.38 不适用

5.39 不适用

5.40 不适用

5.41 不适用

5.42 不适用

5.43 不适用

5.44 不适用

5.45 不适用

5.46 不适用

5.47 不适用

5.48 不适用

5.49 不适用

5.50 不适用

5.51 不适用

5.52 不适用

5.53 不适用

5.54 不适用

苏州晶方半导体科技股份有限公司

证券代码:603005 证券简称:晶方科技

2014 半年度 报告摘要

3.2.2 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	245,528,880.95	34.70
国外	25,846,015.95	60.01

3.3 核心竞争力分析

公司核心竞争力分析详见公司2013年年度报告第四节“董事会报告”相关内容。报告期内,公司核心竞争力发生重大变化。

3.4 投资收益分析

3.4.1 对外投资股权投资分析

2013年5月31日,经公司第一届董事会第九次会议审议通过,公司拟出资人民币2,000万元认购华进半导体封装技术研究中心(以下简称“中心”)新增人民币2,000万元注册资本,并在完成增资后持有该中心13.80%的股权,公司于2014年4月完成出资,相关工商变更登记手续已完成。截至报告期末,公司持有该中心12.42%的股权。华进半导体封装技术研究中心有限公司的主营业务为集成电路封装与系统集成等相关技术研发;半导体集成电路和系统集成产品的技术开发;技术服务及其产品销售;利用自有资产对外投资;培训服务(不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训);自营各类商品及技术的进出口业务。

3.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

报告期内,公司无委托理财事项。

3.4.3 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	募集资金使用率
66,735.81	57,567.60	57,567.60	9,168.21	86.28%

本报告期已使用募集资金总额包含以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的部分,置换金额为740,761.87万元,具体详见公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(临2014-012)。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金承诺投入金额	募集资金实际投入金额	募集资金使用率	项目进度	产生收益	是否达到预计收益	是否发生募集资金用途变更	是否发生募集资金投向变更	是否发生募集资金使用方式变更	是否发生募集资金使用地点变更	是否发生募集资金使用期限变更	是否发生募集资金使用主体变更
12英寸WLCSP封装项目	否	66,735.81	57,567.60	86.28%	完成项目投入	66,455.90	是	否	否	否	否	否	否

募集资金投资项目于2010年,分别于2010年12月和2011年1月取得江苏省环保厅、江苏省经信委的批复,取得相关批复后公司用自有资金对项目进行了预投入,截至2014年2月28日,预先投入金额为49,761.87万元。

2014年上半年,公司完成首次公开发行股票融资的上市挂牌工作,并作为募投项目筹集66,735.81万元的募集资金,2014年4月,公司将预先投入的自筹资金以募集资金进行了置换,由于募集资金到位时间延后,公司募投项目的建设周期有所延长,公司积极推进募投项目的建设工作,力争2014年完成项目的投资与建设,并根据项目的进度和相关要求履行项目验收申请等相关事宜。

3.4.4 主要子公司、参股公司分析

公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
中芯国际集成电路制造(上海)有限公司	集成电路制造	100亿元人民币	11,647.50亿元	11,427.50亿元	-37,560.75万元

3.4.5 非金融类公司委托理财情况

四、利润分配情况

4.1 利润分配政策的制定或变更情况

报告期内,公司无利润分配事项。

五、其他披露事项

5.1 不适用

5.2 不适用

5.3 不适用

5.4 不适用

5.5 不适用

5.6 不适用

5.7 不适用

5.8 不适用

5.9 不适用

5.10 不适用

5.11 不适用

5.12 不适用

5.13 不适用

5.14 不适用

5.15 不适用

5.16 不适用

5.17 不适用

5.18 不适用

5.19 不适用

5.20 不适用

5.21 不适用

5.22 不适用

5.23 不适用

5.24 不适用

5.25 不适用

5.26 不适用

5.27 不适用

5.28 不适用

5.29 不适用

5.30 不适用

5.31 不适用

5.32 不适用

5.33 不适用

5.34 不适用

5.35 不适用

5.36 不适用

5.37 不适用

5.38 不适用

5.39 不适用

5.40 不适用

5.41 不适用

5.42 不适用

5.43 不适用

5.44 不适用

5.45 不适用

5.46 不适用

5.47 不适用

5.48 不适用

5.49 不适用

5.50 不适用

5.51 不适用

5.52 不适用

5.53 不适用

5.54 不适用

5.55 不适用

5.56 不适用

5.57 不适用

5.58 不适用

5.59 不适用

5.60 不适用

5.61 不适用

5.62 不适用

截至2014年6月30日,晶方科技募集资金专户余额为9,337.91万元。

具体使用明细详见《募集资金使用情况对照表》(附附表)。

2. 募集资金使用及披露情况

为确收项目收益并保障项目顺利实施,尽早实现经济效益,公司在2014年首次公开发行股票并上市募集资金到位之前,已自筹资金对项目进行了先行投入,截止2013年2月28日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币497,618,693.27元,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于苏州晶方半导体科技股份有限公司以自筹资金投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(会审字[2014]1328号),公司独立董事与保荐机构出具了《关于晶方科技以自筹资金投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(会审字[2014]1328号),公司独立董事与保荐机构出具了《关于晶方科技以自筹资金投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(会审字[2014]1328号),公司独立董事与保荐机构出具了《关于晶方科技以自筹资金投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(会审字[2014]1328号),公司独立董事与保荐机构出具了《关于晶方科技以自筹资金投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(会审字[2014]1328号),公司独立董事与保荐机构出具了